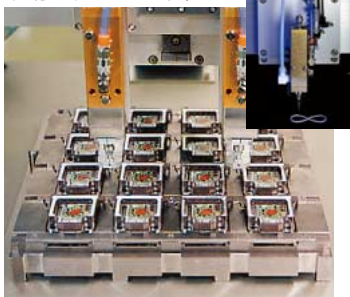


ポッティング材

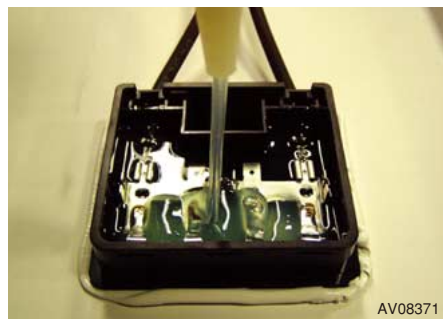
分類	2液エラストマー						
	付加反応						
製品名	EE1840	SH850	SE1815CV	SE1816CV	Sylgard 184	SE9207	SE1740
特長	室温硬化	低温硬化 (非接着タイプ)		低温硬化			低温硬化 透明
難燃性		UL94 V-0			UL94 V-1		
低分子低減グレード			○	○		○	
用途例	LEDモジュール	DC/DC コンバータ トランス	フライバックトランス、 パワースタップライモジュール		センサー ポッティング PDMSモールド	LEDモジュール	光学部品
混合比	100:100	100:100	100:100	100:100	100:10	100:100	100:100
外観	黒	赤褐色	赤褐色	黒	透明	黒	透明
粘度 [25°C] (mPa・s) *1)	1,100	3,500	2,300	2,400	3,900	700	900
ポットライフ [25°C] (時間) *2)	0.17	3	8	24	>2	6	24
硬化時間 (時間/°C)	168/25	0.25/100	0.5/150	1/100	0.7/125	2/80 + 72/25	0.5/80
硬化後物理特性							
密度 [25°C] (g/cm ³)	1.01	1.53	1.55	1.36	1.03	0.97	1.00
硬さ [JIS タイプA]	21	68	72	38	50	4	34*4)
針入度 [JIS K2220] (mm/10)	—	NA	NA	NA	NA	NA	NA
引張強さ (MPa)	0.55	3.0	4.2	2.7	—	—	—
伸び (%)	185	100	90	200	—	—	—
線膨張係数 (1/K)	—	2E-04*5)	2E-04	3E-04	3E-04	—	—
熱伝導率 (W/m・K)	—	0.6*5)	0.6	0.4	0.18	—	—
低分子シロキサン成分量 (%) *6)	—	—	0.03	0.02	—	0.01	—
硬化後接着特性							
引張りせん断接着強さ (N/cm ²)	35	NA	226/AL	145/AL	—	20/PC	20/GL
硬化後電気特性							
絶縁破壊強さ (kV/mm)	17	29	30	26	21	21	17
体積抵抗率 (Ω・cm)	3.2E+15	1E+14	1E+15	2E+15	1E+14	3E+14	1E+15
誘電率 [1MHz]	3.1	3.2	3.1	4.3	2.7*7)	2.6	2.8
誘電正接 [1MHz]	2.7E-03	1E-03	3E-03	1E-02	<1E-03*7)	5E-04	1E-04

*1) 2液は混合後粘度 *2) 常温にて2液混合後の粘度が2倍になるまでの時間 *3) スナップタイム *4) 00硬度 *5) 硬化条件 1時間/100°C *6) 低分子シロキサン D4~D10 *7) 100 kHz

●1液ディスペンサー装置



岩下エンジニアリング株式会社様 ご提供



AV08371